



**THERMOCHIP FLOOR** es la solución para **forjados interiores** y **entreplantas**. Se instala sobre la estructura portante del forjado y una banda de caucho. Sobre él se puede disponer un tablero de alta densidad y un panel técnico de suelo radiante, configurable según la demanda energética de cada proyecto. El panel se recubre con un tablero de fibro-yeso que servirá de soporte al revestimiento final de la estancia.

#### COMPOSICIÓN

Interior fibro-yeso  
 Núcleo poliestireno extruido  
 Interior fibro-yeso

Cara interior	Espesor núcleo	Cara interior	Dimensiones			Paneles / palet	m <sup>2</sup> panel / palet	Transmit. térmica	Peso panel	
			Grosor	Largo	Ancho				kg/m <sup>2</sup>	kg/panel
12	40	12	64	2400	550	34	44,88	0,774	30,03	39,64
12	50	12	74	2400	550	28	36,96	0,663	30,35	40,06
12	60	12	84	2400	550	26	34,32	0,558	30,67	40,48
12	80	12	104	2400	550	20	26,40	0,423	31,31	41,33
12	100	12	124	2400	550	16	21,12	0,341	31,95	42,17
12	120	12	144	2400	550	14	18,48	0,285	32,59	43,02
12	160	12	184	2400	550	10	13,20	0,215	33,87	44,71

Resultados de ensayos realizados sobre THERMOCHIP FLOOR, incluyendo suelo radiante y capa de fibroyeso:

\* [HR] Aislamiento global en dBA según el DB-HR R(A) = **43,5 dBA**

\*\* [SI] Reacción a fuego **B-s1, d0**.

\*\*\* La luz máxima para fragmentos de panel biapoyados será de 1.20m, con dimensiones de panel >1.20m han de disponerse tres apoyos



THERMOCHIP, S.L.U.

A Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713 info@thermochip.com

www.thermochip.com

THERMOCHIP  
**HOUSING**